



KC ČIP.SI
SLOVENSKI KOMPETENČNI
CENTER ZA ČIPE

NOVIČNIK

Petek, 10. april 2026

Pozdravljeni,

tudi v tem tednu vam pošiljamo izbrane informacije in novice s področja čipov in polprevodniških tehnologij

Dogodki:

- Webinar: **[Chips Venture Forum 2026 – How to Prepare to Meet the Right Investors in Semiconductors](#)**
23. april 2026, 13:00, on-line
Zainteresirani boste seznanjeni, kako bo potekal dogodek Chip Venture Forum, kakšen je postopek izbora ter kaj lahko kot zagonsko podjetje pričakujete.
Za vse nadaljnje informacije se obrnite na glavno pisarno KC Čip.si office@cc-chip.si ali pa nas pokličite na +386 (0)1 476 8850.
- On-line delavnica: **[DG Competition - Reality check on the proposal for review of the General Block Exemption Regulation with regard to State aid for research and development](#)**
15. april 2026, 10:00-12:00, on-line
Delavnica se bo osredotočala na državno pomoč za raziskave in razvoj (R&R) v okviru revizije uredbe GBER.
Za sodelovanje je potrebna predhodna registracija preko povezave [tukaj](#).
- Webinar: **[Building the Future Together: Integrating Sustainability in the Semiconductor Ecosystem](#)**
15. april 2026, 13:00-14:30, on-line
Elektronika prihodnosti temelji na vpeljavi trajnostnih pristopov v ekosistemu polprevodnikov.
- Delavnica: **[IMAPS Italy Workshop Advanced packaging](#)**
5. maj 2026, Politecnico of Milano Consiglio Hall, Milano, Italija
Delavnica združuje strokovnjake s področja naprednega pakiranja v mikroelektroniki ter ponuja vpogled v najnovejše tehnološke trende in raziskave.
Udeležba je brezplačna, vendar je [registracija obvezna](#).
- Webinar: **[Southeast Asia's Rise in Global Semiconductor Value Chains by CHIPDIPLO](#)**
30. april 2026, 9:00-10:15 h, on-line
Tema webinarja bo obravnavala naraščajočo vlogo Malezije, Vietnama, Filipinov in Singapurja v globalnih vrednostnih verigah polprevodnikov.R

Razpisi:

- **[APECs Open Access Call for Semiconductor Technologies](#)**
Odprt razpisi omogoča dostop do naprednih pilotnih linij in R&D infrastrukture za razvoj in validacijo tehnologij na področju polprevodnikov (CTR, MPW, packaging, fotonika).
Rok za prijavo je 30. junij 2026

Ostale novice:

- **[transistor for next-generation 3D stacked semiconductors operates without current leakage](#)**
Raziskovalci iz Južne Koreje so razvili tranzistor za naslednjo generacijo 3D-zloženih čipov, ki deluje praktično brez uhajanja toka.
- **[Photonic chip packaging can withstand extreme environments](#)**
Raziskovalci ameriškega inštituta NIST so razvili novo metodo pakiranja fotonških čipov, ki omogoča zanesljivo delovanje tudi v ekstremnih okoljih
- **[TSMC rides AI wave to net nearly 70% of global foundry market in 2025](#)**
TSMC je leta 2025, predvsem zaradi eksplozivne rasti povpraševanja po čipih za umetno inteligenco, povečal svoj delež na skoraj 70 % svetovnega trga
- **[Which Chips Actually Matter?](#)**
Evropa ponovno preučuje svojo strategijo na področju polprevodnikov po opozorilnem primeru Nexperije.

Želimo vam prijetne praznike,
vaš KC Čip.si



Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran (v izdelavi): <https://cc-chip.si/>



Financira
Evropska unija



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavljene na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

[Odjava](#)

